

**FUJIMI**  
FUJIMI INCORPORATED  
株式会社フジミインコーポレーテッド

# BUSINESS REPORT 2019



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

Copyright (C) 2019 Fujimi Incorporated. All rights reserved.  
Printed in Japan

**FUJIMI**  
FUJIMI INCORPORATED  
株式会社フジミインコーポレーテッド

# 技術を磨き、 心をつなぐ

Polishing our technologies and  
bringing people together

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした  
さまざまな産業で活かされています。

フジミはお客様にあらゆる製品を磨いていただくことで、  
人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

Our polishing technologies can be utilized  
in various industries, including the semiconductor industry.  
By polishing our customers' products with our abrasives,  
we contribute to a future society where people  
can live together comfortably.

1950年の創業以来、私たちは一貫して「ものづくり」にこだわり、製品の品質化と安定供給に努めております。私たちを取り巻く環境は変化が早く、常に進歩していますが、自らのコア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。

ますます多様化するお客様のニーズや技術の高度化に対して、迅速かつ確に対応し、お客様に満足いただける製品・サービスを提供することで、未来の創造へ貢献してまいります。そして、新たな事業への挑戦にもアイデアを創出し、果敢にチャレンジしてフジミのさらなる発展のために全力で取り組んでまいります。

Since our establishment in 1950, we have been committed to manufacturing excellence and we have continuously made efforts to deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business. Although the environment surrounding us is quickly changing and constantly improving, we have endeavored to earn our customers' trust and to further satisfy our customers by advancing our leading-edge core technologies.

We will contribute to the creation of a better future by responding swiftly and accurately to increasingly diverse customer needs and technological sophistication and providing products and services that satisfy our customers. Also, we will create ideas for new business in which we can challenge ourselves and we will make every effort to further develop FUJIMI.



代表取締役社長

関 敬史

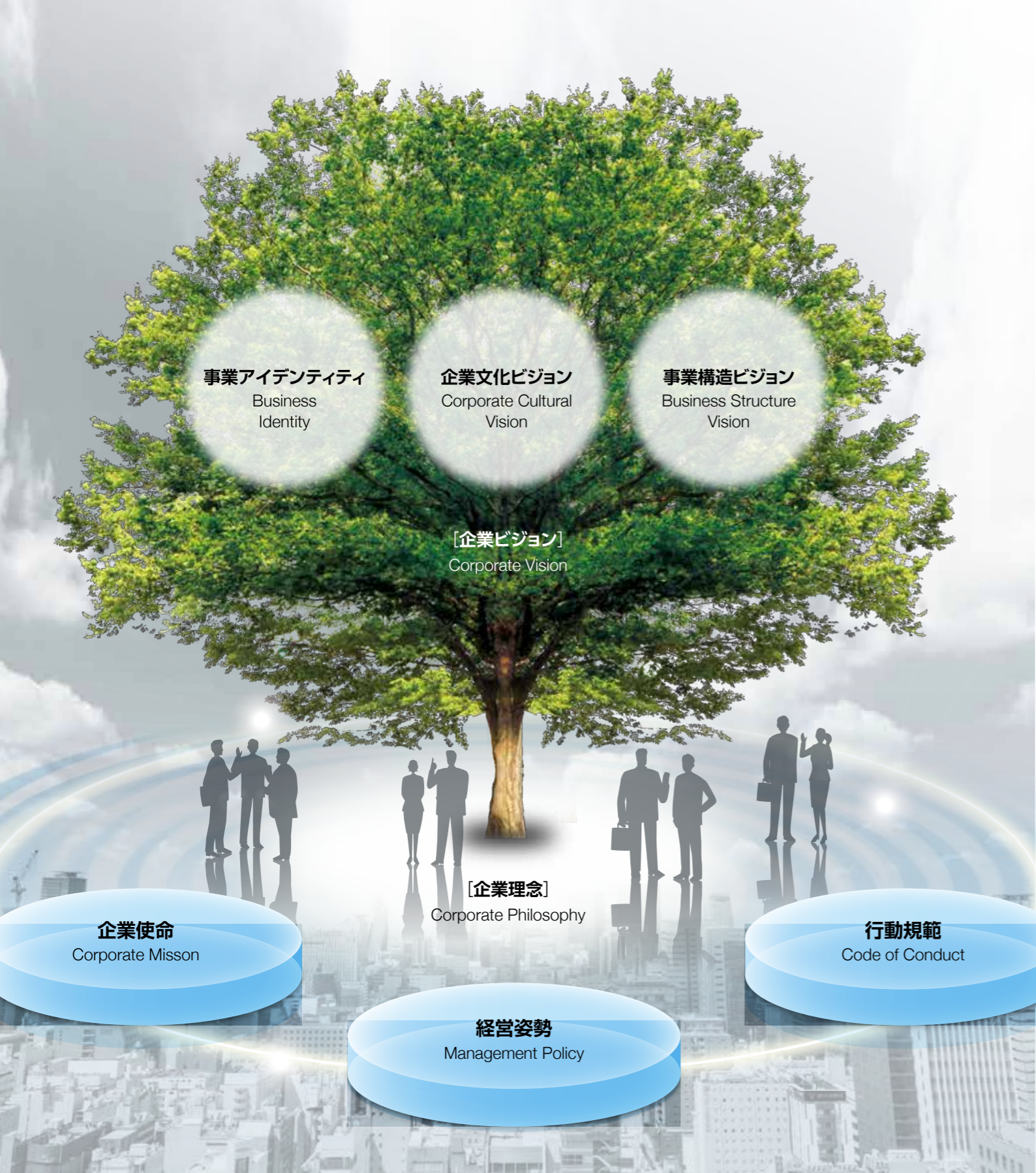
Keishi Seki, President

## CONTENTS [目次]

あいさつ Message	1	経営指標 Selected Financial Data	19
経営方針 Management Objectives	3	連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet	21
中長期経営計画 Medium & Long Term Business Plan	5	連結損益計算書 Consolidated Statement of Income	23
事業紹介 Business	7	連結包括利益計算書 Consolidated Statement of Comprehensive Income	23
フジミのものづくりと社風・風土 Fujimi's Manufacturing and Corporate Culture	13	連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statement of Cash Flows	24
グローバル展開 Global Expansion	14	沿革 History	25
暮らしの中のフジミ Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	15	会社データ Corporate Data	26
製造工程の中のフジミ Fujimi's Products in Manufacturing Process	17		

# 経営方針

## Management Objectives



### 企業理念 Corporate Philosophy

#### [企業使命]

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

#### [経営姿勢]

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・一人ひとりが「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる会社を目指します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

#### [行動規範]

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・一人ひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

#### Corporate Mission

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

#### Management Policy

- ・We adopt the customer's point of view to create solutions that meet the customer's needs and expectations.
- ・We aim to be a company that motivates employees to excel by creating a great work culture.
- ・We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- ・We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders' confidence and trust.

#### Code of Conduct

- ・We act with customer satisfaction in mind.
- ・We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- ・We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- ・We respect each person's ideas.
- ・We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

### 企業ビジョン Corporate Vision

#### [事業アイデンティティ]

パウダー&サーフェス分野で世界最高技術を提供し、私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

#### [企業文化ビジョン]

強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切にし、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

#### [事業構造ビジョン]

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

#### Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an "excellent company." Being an "excellent company" means not only having excellent results. It also includes the following.

- ・Respond to change precisely, and grow continuously.
- ・Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- ・Contribute to decreasing the environmental impact as a member of a recycling-based society.

#### Corporate Cultural Vision

Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- ・Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- ・Be nice, cooperative and appreciative of colleagues. (Kind)
- ・Have a future plan, and form diverse working groups to achieve such plan. (Exciting)

#### Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

# 中長期経営計画

## Medium & Long Term Business Plan

2016年11月に新たな中長期経営計画を策定し、中長期ビジョンに「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を据えました。これは、社員一人ひとりから自発的なアイデアとチャレンジが次々と生まれ、それを育む土壌を整えることで、環境の変化に対応し、企業文化ビジョンに掲げた「強く、やさしく、面白い」会社に向かっていくことを意図したものです。

当社はこれまで半導体市場を主たる事業領域とし、主に精密研磨材を開発・製造・販売してまいりましたが、事業環境の変化は激しさを増しています。長らく半導体市場の主役であったパソコンは2012年以降出荷台数の減少が続いており、その後市場を牽引してきたスマートフォンも既に成長率は大きく鈍化し、ポストスマートフォンに向けた新たな業界再編の動きが活発化しております。

こうした事業環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要であると考え、非半導体売上構成比の向上を目指してまいりました。一方で、当社は2012年に事業ドメインを「パウダー＆サーフェス」と定めましたが、実際のところは従前同様に研磨材を中心とした事業活動が軸となっております。

中長期経営計画では、「ろ過・分級・精製技術」「パウダー技術」「ケミカル技術」からなる当社のコア技術を活かし、「パウダー＆サーフェス」に加え、「表面加工のソリューション」へ事業ドメインの拡大を目指してまいります。具体的な取り

組みとしては、短期から中期的には既存事業での深掘りと周辺領域の新規用途開拓を進め、中期的には「パウダー＆サーフェス」を意識した非研磨用途・事業を拡充し、さらには10年先を見据えた長期視点での育成を進めてまいります。

なお、長期視点の活動につきましては、2015年4月に先端技術研究所を設置し、既に取り組みに着手しております。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、引き続き成長のための積極的な開発投資を行ってまいります。

上記取り組み成果を測る指標として、非半導体売上構成比に加え、新規事業売上構成比、非研磨分野売上構成比についても目標を定め、定期的に進捗管理を行うことで、安定的かつ持続的な成長に繋げてまいります。

また、成長分野への積極投資と併せ株主の皆様への還元を強化（配当性向を50%以上）することで資本効率（ROE、ROA）を高めると同時に、CSR活動においては、これまでの活動に加え、両立支援、女性活躍推進等にもより一層力を注ぎ、企業価値増大を目指してまいります。

In November 2016, we drew up a new Medium & Long Term Business Plan and set our Medium & Long Term Vision as “We support your forward-looking ideas and challenges.” This comes with the intent of striving towards a company that is “Strong, Kind and Exciting,” as stated in our Corporate Cultural Vision. This is realized by adapting to the changing environment made possible by cultivating the space for the growth of the voluntary ideas and challenges of each individual employee.

Until now, we have mainly developed, produced and sold precision abrasives with the semiconductor market as our main business area. However, the changing business environment is only getting more severe. Personal computers that have long been the key player of the semiconductor market, have seen a decline in shipments since 2012, and even smartphones that have held up the market since have seen a large slowdown in growth. Currently, there is increasing activity in industry reorganization in preparation for the post-smartphone era.

We believe a business structure that does not lean towards specific markets or needs is crucial in order to attain a stable and continued growth in such a business environment, and have thus aimed to improve our sales distribution ratio of non-semiconductors. On the other hand, although we established our business domain as “powder and surface” in 2012, in actuality, most of our activity was centered around abrasives as seen previously.

With the Medium & Long Term Business Plan, we aim to

expand our business domain to “polishing solutions” in addition to the current “powder and surface” area by our core technologies; filtration, classification, and refinement technologies, powder technologies, and chemical technologies. In the short to mid term, we will expand existing business and develop new application of peripheral areas, while in the mid term, we will expand the application and business of non-polish with “powder and surface.” Furthermore, we hope to continue this growth with the long term, even 10 years.

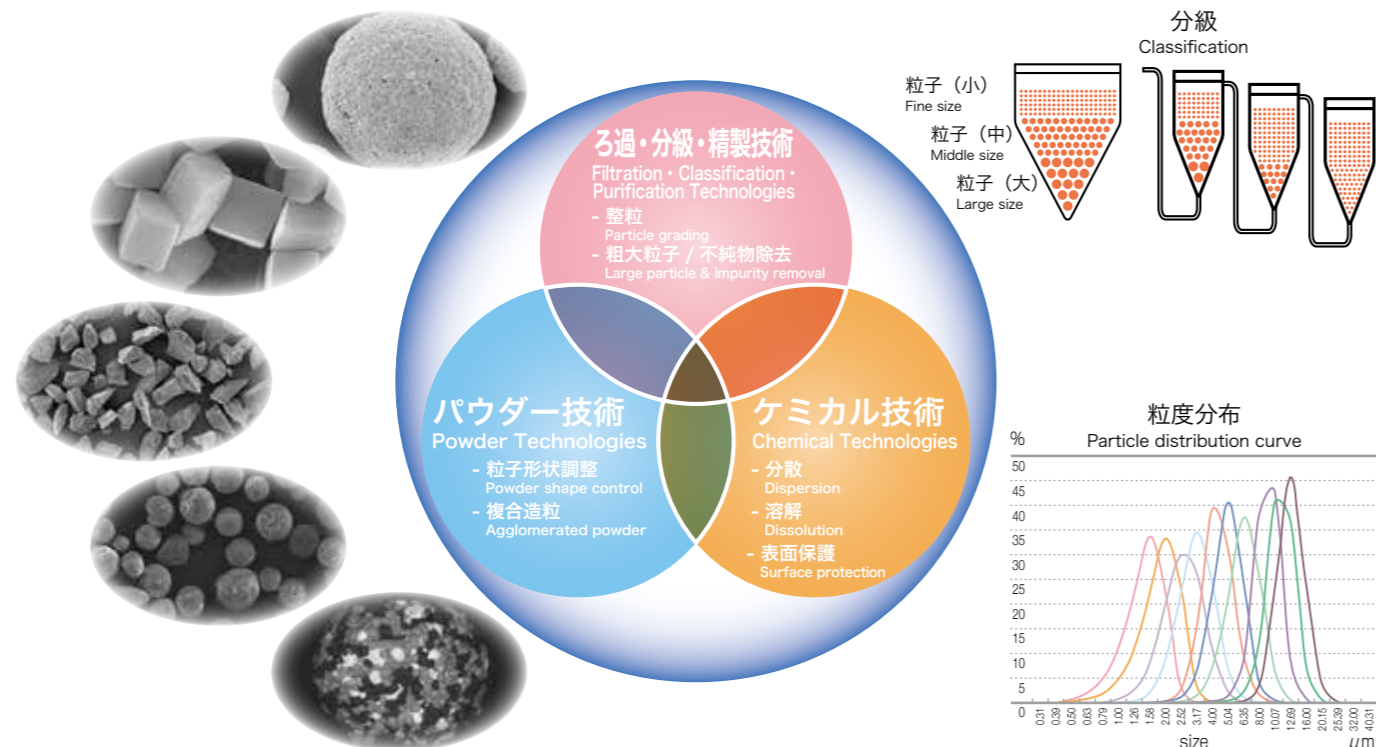
Also, we have begun working on long term activities by setting up the Advanced Technology Research Center in April 2015. We will continue proactive development investments to achieve continuous growth with our solid financial base.

As an index for measuring the success of the above endeavors, we are striving for stable and continuous growth by periodically managing progress through setting goals for the sales distribution ratios for new business and the sales distribution ratios for non-abrasive areas, on top of those of non-semiconductors.

We will strive to largely increase our corporate value by strengthening the return to our shareholders coupled with our active investments in growing areas (over 50% payout ratio), increase capital efficiency (both ROE and ROA), and place more effort into promoting female activity and work-parenting support as part of our CSR activities.

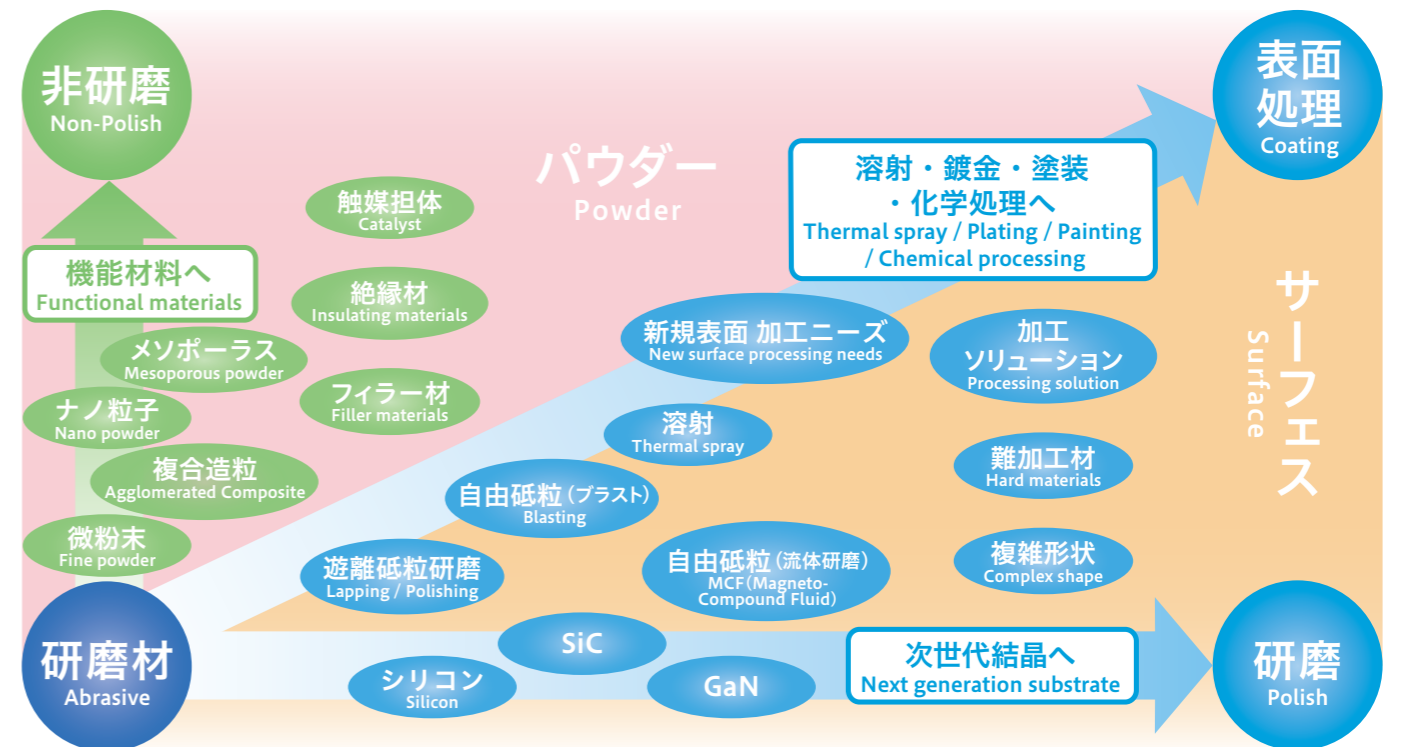
### 当社のコア技術

#### Fujimi's Core Technologies



### 研磨材メーカーから「パウダー＆サーフェスカンパニー」へ

#### Conversion from Abrasive Manufacturer to “Powder & Surface Company”



# 事業紹介

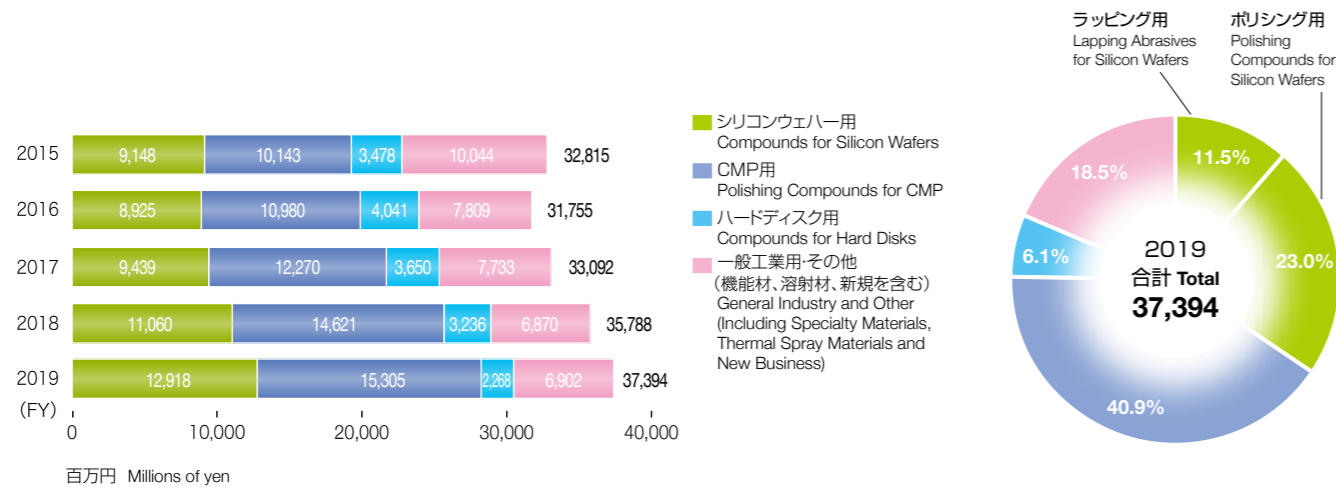
## Business

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。なかでも、主力事業分野である半導体基板向け超精密研磨材では世界ナンバーワンのマーケットシェアを維持しており、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、市場優位性を維持しております。

ここでは、当社の各事業と先端技術研究所をご紹介します。

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

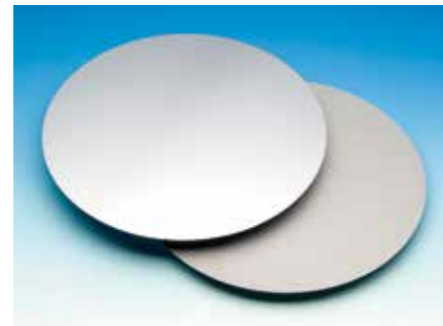
### 用途別製品売上高 Sales by Application



### シリコン事業

#### 事業概要

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。切断から仕上げ研磨まで高品質な製品・サービスを揃え、高度化するお客様の要求に応じております。引き続き新技術に支えられた独自性の高い新製品を提供し、「最も信頼されるパートナー」を目指してまいります。また、近年注目されているパワーデバイス基板向け製品開発にも注力し、一部上市しております。



#### 研究開発活動

300mm シリコンウェハーの需要拡大、デザインルールの微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①高平坦化、②高平滑化、③無欠陥化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなってまいります。

高平坦化や生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工力、加工精度および加工歩留まり向上を共に満足する製品の検討を進めております。

一次研磨工程用スラリーとしては、ウェハー中心部から最外周部まで超平坦に加工できる差別化製品から、高速研磨型やリサイクル性付与型等お客様の生産性向上につながる製品までを、また、最終仕上げ研磨工程用スラリーでは、配線間隔が5nmのウェハー研磨用として研磨後表面のナノ欠陥を激減し原子レベルの平滑性を実現するポリッシング材の開発を、砥粒・添加剤設計、配合技術を応用しながら取り組んでおります。

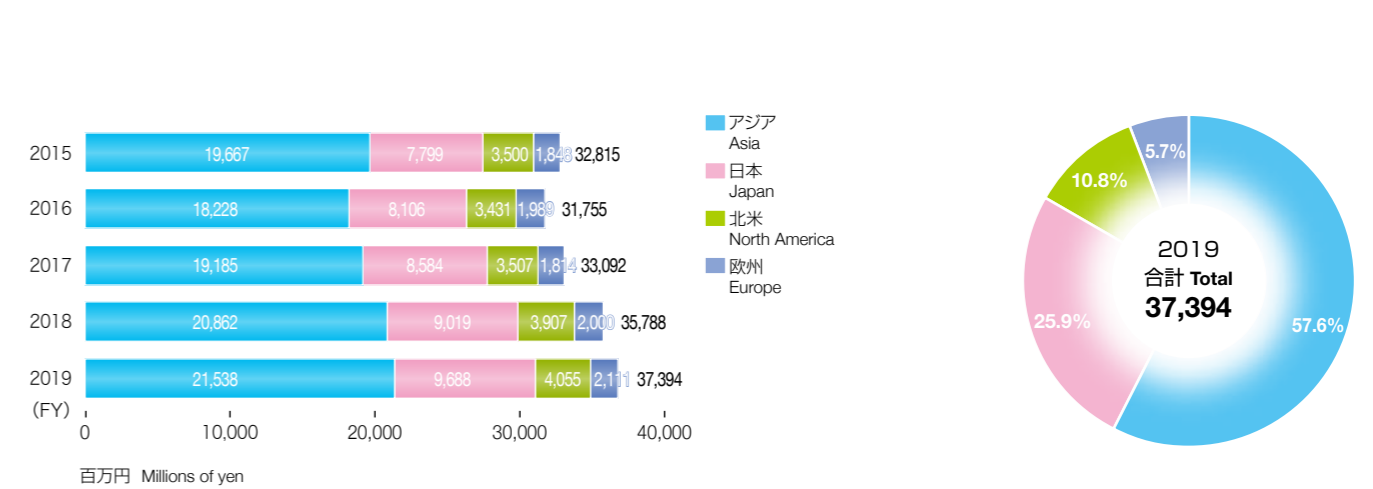
さらには、近年次世代パワーデバイスとして SiC や GaN 系の半導体が注目されております。これら難加工基板用研磨材の研究開発も進めており、高速・高面質となる新たな製品・プロセス開発に取り組んでおります。

Drawing on the know-how and R&D capabilities accumulated since its founding, Fujimi has developed numerous products essential for leading-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (chemical mechanical planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and hard disk polishing. In particular, Fujimi holds the top global market share for high-precision abrasives for semiconductor substrates, a core business area, and maintains its market superiority as the leading name in synthetic precision abrasives.

Here, we will introduce each of our business and Advanced Technology Research Center.

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 地域別売上高 Sales by Region



### Silicon Business

#### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the high-precision polishing process in which silicon wafers, which become semiconductor substrates, are flattened and mirror polished. We offer high-quality products and services for every step of the process from cutting to polish finishing, satisfying the increasingly sophisticated requirements of our customers. We aim to become our customers' "most trusted partner" by continuing to provide highly distinctive new products supported by new technologies. In addition, we are focusing on the development of products for power device substrates, which have received attention in recent years, and have put some of these products on the market.

#### Research and Development Activities

As there is an increase of demand for 300mm silicon wafers in the market, as well as a further shrinking of design rules, requirements of super precise polishing for 1) high flatness, 2) low roughness, 3) defect free, 4) metal contamination free and 5) productivity improvement are getting stronger and stronger.

For the application of silicon lapping and slicing abrasives, for which high flatness and high productivity are needed, we are proceeding with activities to satisfy the cutting rate, quality and yield for customers.

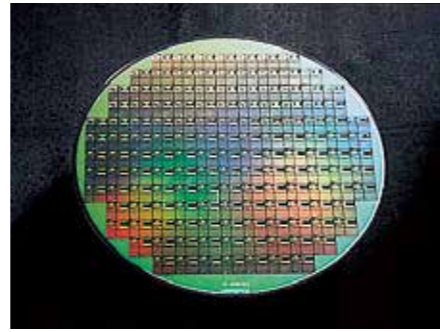
For the application of silicon stock polishing slurry, we are exclusively developing new products, not only to produce a super flat silicon wafer from the wafer center to the furthest area on the periphery, but also to enhance the productivity for customers through a high stock removal rate and longer recyclable slurry. And for the application of the final polishing slurry to meet a 5nm level node, we are also developing new products that can reduce nanometer-sized defects drastically and improve the atomic level roughness after polishing based on abrasive/additive design and formulation technology.

Furthermore, SiC and GaN semiconductors have recently been focused on as next-generation power devices. We are proceeding with R&D activities on the slurry for such a hard material and are working to develop a new product/process for a high removal rate with a high surface quality.

## CMP事業

### 事業概要

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。半導体デバイスは高性能化、高密度化、高集積化に伴い、CMPが適用される工程は増加傾向にあります。お客様の製造・開発拠点に近い、日本、米国、台湾に製造・開発拠点を設け、お客様とより密接な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を開発しております。また、成長が期待される中国市場に対しても、開発および販売活動を強化しております。



### 研究開発活動

先端の半導体デバイスの微細化が進捗し、ロジックデバイスではテクノロジーノード7nmのデバイスが量産化され、5nmのデバイスの研究開発が活発化しております。微細化の進展に伴い、Fin FET と呼ばれる3次元構造のトランジスタが使われています。また、NAND型フラッシュメモリにおいては3次元に積層し、高密度化した3D NAND と呼ばれるフラッシュメモリの量産が拡大しております。さらには、DRAM や異種のデバイスを3次元に実装するためにスルーシリコンビア (TSV) 技術の量産適用もされています。これらの新トランジスタや新構造の形成においても、CMPプロセスが適用され、その用途はますます広がっております。

当社では、多結晶シリコン薄膜用やCu配線形成用にポリシング材を開発しておりますが、上記のようなCMPプロセスの用途拡大にあわせ、新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めております。微細化、高密度化とともに高度化するお客様の要求にお応えするため、当社では最先端の研磨装置、評価装置、分析装置を活用すると同時に当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っております。

## ディスク事業

### 事業概要

パソコンやサーバー、ゲーム機、高画質レコーダーなどの記録媒体であるハードディスク用基板の製造工程に用いられる研磨材を製造販売する事業です。お客様の生産拠点が集中するマレーシアに製造拠点を置くとともに技術スタッフを配置し、技術サポートを実施することでお客様との信頼関係を構築しております。また、次世代ディスク基板への要求を早期に入手し具現化するため基礎開発の拡充も図り、お客様の要求に合った新製品をタイムリーに提供してまいります。



### 研究開発活動

増大していくデジタルデータの保存要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速されています。現在、ハードディスク基板はナノレベルの欠陥が問題とされており、欠陥数および欠陥サイズの低減要求はさらに厳しくなっております。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動により新製品の開発を推進しております。

## 機能材事業

### 事業概要

電子部品、自動車、レンズ等に使用される精密砥石、研磨布紙およびラッピング・ポリシング・プラスト向けの研磨材と充填剤等として使用される機能性材を製造販売する事業です。粒子形状・粒度分布制御を始めとするパウダー技術を活かし、お客様のご要望に的確な対応をすることにより潜在的なニーズまでも引き出し、更に信頼を高めてまいります。また、砥粒の新たな用途についても技術力を強化し、探索を進めております。

### 研究開発活動

プラスチックレンズ、ガラスなどの多様な表面に適した研磨材および原材料となる焼結材や超微粒子の開発に取り組んでおります。お客様のご要求を的確に捉え、当社のコア技術を活用してお客様にご満足いただける製品の開発を推進しております。

## CMP Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the manufacturing process of semiconductor devices. CMP is increasingly used in the manufacturing process of semiconductor devices as they have become more highly-functional and highly-integrated products with higher density. We have established manufacturing and development bases in Japan, the United States, and Taiwan, which are located near the manufacturing and development bases of our customers, thereby building closer relationships with customers and developing new products in accordance with customers' roadmaps. Additionally, we are reinforcing development and sales activities in Chinese markets, which are expected to grow in the future.

### Research and Development Activities

As the shrinking of leading-edge semiconductor devices is progressing, the mass production of 7nm technology nodes for logic devices and the research and development for devices of 5nm technology nodes are actively moving forward. Alongside the shrinking trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, is being used. Also, the NAND flash memories are now laminated in 3 dimensions, while mass production for further high-density flash memory called 3D NAND is expanding.

Furthermore, Through Silicon Via (TSV) technology that mounts DRAM and other types of device in 3 dimensions has already moved into mass-production. The CMP process is applied to forming these new transistors and new architectures as well with the strong prospect of expanding its use.

Although we have already developed slurries for polycrystal silicon films and Cu wiring, we have also launched development of slurries that can be used with new materials and structures to expand the use of the CMP process as mentioned above. We are employing state-of-the-art polishing, evaluation, and analysis equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer requirements for higher levels of shrinking densification and sophistication.

## Disk Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the manufacturing process of substrates for hard disks, which are storage media for devices such as personal computers, servers, video game consoles, and highdefinition recorders. We have a manufacturing base in Malaysia, in which our customers' production bases are concentrated, and we have built relationships of trust with our customers by allocating technical staff and providing technical support in the region. In addition, we endeavor to expand the areas of basic development in order to grasp customers' requirements for next-generation disk substrates at an early stage, thereby promptly providing new products that meet customers' requirements.

### Research and Development Activities

The development of next generation hard disks has been accelerated for the required storage of increasing digital data. Today, the requirements for fewer and smaller defects are getting severer than ever, as nanometer-level defects are considered problems for the hard disk substrates. To meet these requirements, we have been driving new product developments through activities together with our customers.

## Specialty Materials Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell specialty materials used for products such as electronic parts, automobiles, and lenses as precision grindstones, lapping cloth and paper, and polishing agents, filling materials, or the like for lapping, polishing, and blasting. Utilizing technologies for controlling particle size distribution and particle shape as well as other powder technologies, we even draw out potential customer needs by appropriately responding to customer requests, and this in turn improves customer trust. Further, we seek to discover new applications for abrasive grains by reinforcing our technological capabilities.

### Research and Development Activities

We have been developing polishing agents, sinterd particles and ultrafine particles for raw materials of the polishing agents suitable for various surfaces, such as plastic lenses and glass. To grasp customer's requirements accurately, we promote the development of products that can satisfy customers by utilizing our core technologies.

## 新規事業

### 事業概要

既存事業以外のさまざまな新規用途で用いられる、多種多様な材料（金属、樹脂、セラミック、複合材料など）や形状（2次元、3次元）に対応した研磨材等を製造販売する事業です。世界のさまざまな業界のお客様から寄せられる、新たな表面創成のご要望に、研磨材のみならず用途に応じた周辺消耗材や装置までも含めたトータルソリューションでお応えしてまいります。

### 研究開発活動

素材金属、セラミック、樹脂から複合材料にいたる多種多様な素材、またさまざまな形状に適した研磨材等の開発に取り組んでおります。新規用途では、研磨材のみならず、用途に応じた装置や周辺消耗材の推奨も含めた、加工プロセスの開発・提供も必要とされております。最先端の表面創成ウォンツに、トータルソリューションでお応えし、新規市場開拓を推進してまいります。



## 溶射材事業

### 事業概要

鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界における長寿命化、高機能化を実現するために、環境に優しい表面処理として使用される溶射用途向けに、主にサーメット、セラミックスなどの粉末溶射材を製造販売する事業です。粉末造粒技術を強化し、タイムリーなソリューション提案を行うとともに、3Dプリンター用材料等の新規市場開拓による売上拡大を目指してまいります。



### 研究開発活動

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高機能皮膜への要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が期待されております。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めております。これら市場の期待に応えるべく、複合造粒技術やスラリー化技術などを活かした最適溶射材の開発に重点を置き推進してまいります。また、3Dプリンター用材料の開発と積層成型技術に関する研究を加速させております。

## 先端技術研究所

先端技術研究所は、1) 基幹技術開発（基盤技術を強化し深耕、新規技術の開発）、2) 開発企画（新規事業機会の創出と育成）、3) 事業企画（M&A、ベンチャー企業投資の実行と推進）の3つを遂行するため2015年4月に設立しました。それ以降、展示会や学会、大学、公的な研究機関などと連携活動を活発化し、“パウダー&サーフェス”分野での新規事業に結びつくテーマ探索に努めてまいりました。それら活動の結果、現在は非半導体・非研磨分野において、幾つかの新規研究開発テーマで外部との共同開発を開始しております。



さらに2015年11月にベンチャー投資組合を設立し、これまでに有望なベンチャー企業6社への投資を行いました。今後もこれらの活動を推進し、新規事業の創出に努めてまいります。

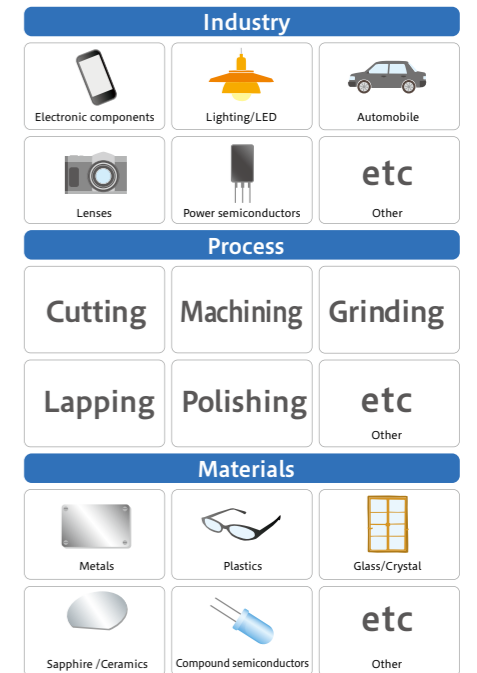
## New Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives and other products for a wide variety of materials (metal, resin, ceramic, and composite materials) and shapes (two-dimensional and three-dimensional) for new applications other than those covered by existing business. We will continue to serve the new surfacing requests of customers from all walks of industry by providing not only abrasives but also total solutions, including the recommendation of application-specific equipment and consumables.

### Research and Development Activities

We are developing abrasives and other products for metal, ceramic, and composite materials resin for new applications (e.g., LEDs, displays, mobile device, etc.) other than semiconductor, hard disk and other applications covered by existing business. To speak to new applications, on top of abrasive products, development and provision of total manufacturing process are also necessary along with the recommendation of application-specific equipment and consumables. We will provide total solutions for the requests of state-of-the-art surface creating, which develops new markets.



## Thermal Spray Materials Business

### Business Overview

In this business, we mainly manufacture and sell powdered thermal spray materials such as cermets and ceramics for thermal spray applications, which is environmental-friendly surface processing, in order to meet the demand for longer product life and higher product functions in a variety of industries including iron and steel, aircraft, and semiconductors. We aim to increase sales by reinforcing our powder granulation technologies, promptly offering solutions, and developing new markets such as materials for 3D printers.

### Research and Development Activities

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is a growing need for highly functional films across a wide range of products, such as aircrafts, semiconductors and general industrial equipment; thus, broader use of thermal spray films is expected. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are “lower temperatures” and “micronization,” as means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of appropriate thermal spray materials by applying our compounding, granulation and slurring technologies.

## Advanced Technology Research Center

The Advanced Technology Research Center was established in April 2015 in order to achieve the following three tasks: (1) Develop foundational technology (strengthens and deepens core technologies while also developing new technology); (2) Plan development (creates and fosters new business opportunities); and (3) Plan business (execute and promote M&A and venture business investments). Since then, we have been striving to explore themes that can connect to new business in the powder and surface fields by actively promoting exhibitions, academic conferences and collaborative activities with universities and public institutions. As a result of such activities, we have now begun joint development with external companies on new research and development themes in multiple fields regarding non-semiconductors and nonabrasives.

Furthermore, we established a venture investment fund in November 2015, and invested in six high-potential venture companies so far.

We will continue to promote these activities and make an effort to have new business in the future.

# フジミのものづくりと社風・風土

## Fujimi's Manufacturing and Corporate Culture

### ものづくり Manufacturing

創業以来培ってきた独自の製造技術と自社設計の製造設備により、品質のバラツキを抑えた製品の量産体制を整えています。その一方で、お客様の高度化・多様化する要求にお応えするため、原材料の調達から生産現場、そして梱包・出荷にいたるまで一貫した少量多品種の生産体制も確立しています。

お客様にお届けする製品を信頼してご使用いただくために、厳しい製品検査と品質管理を行っています。

We have created a mass production system that reduces variations in quality through internally designed production facilities and unique production techniques cultivated since the company's founding. On the other hand, in order to respond to our customers' increasingly complex and diverse demands, we have also established a system of manufacturing small quantities of diverse products that integrates every step from the procurement of raw materials to their processing, packaging and shipping.

We conduct strict product inspections and conduct quality management to provide our customers with products they can use with confidence.



### 社風・風土 Corporate Culture

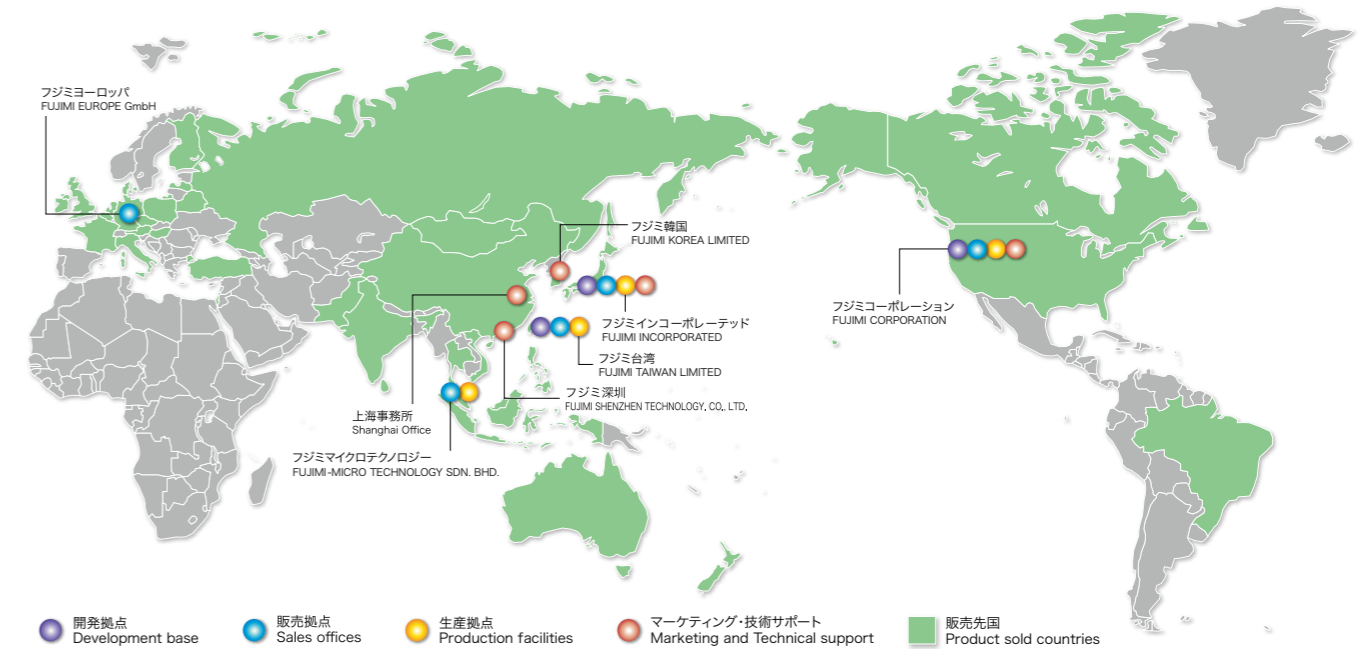
当社では、社員一人ひとりが自ら考え、自発的に行動することを求めています。年齢や職位に関わらず、自ら手を挙げチャレンジすることを奨励する社風です。教育制度では職能別の研修はもちろんのこと、一人ひとりに合ったキャリアを会社と一緒に考えるキャリアデザイン研修や、成長意欲の高い社員には社外スクールへの通学費用支援や博士等の学位取得支援も行っています。また、海外売上構成比が70%を超える当社では、語学研修にも力を入れており、希望する若手社員を対象に海外子会社へ派遣し、現地での業務を通じて語学力をはじめ対話力や提案力等の向上を支援する海外トレーニー制度もあります。高い意欲と最後までやり遂げる責任感のある社員の成長を全力でバックアップしています。

At Fujimi, each employee is asked to think independently and take action with initiative. Our corporate culture encourages those willing to raise their hands and take on challenges, regardless of age and position. In terms of educational systems, in addition to functional training, we offer career design training that considers the careers that suit each individual staff member together with the company. For highly motivated employees, we provide support for expenses to allow them to attend school outside the company, as well as support employees obtaining doctoral degrees. As our overseas sales ratio exceeds 70%, we are focusing on language training, as well as providing a training program that gives opportunities to gain experience at our overseas subsidiaries. We support motivated employees with a sentence of responsibility.



# グローバル展開

## Global Expansion



### 事務所・拠点 Plants and Offices

#### 本社・枇杷島工場 Headquarters / Biwajima Plant

〒452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1  
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166  
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi 452-8502, Japan  
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

#### 稲沢工場 Inazawa Plant

〒492-8329 愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1  
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi 492-8329, Japan

#### 各務原工場 Kakamigahara Plant

〒504-0927 岐阜県各務原市上戸町 7-1-8  
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu 504-0927, Japan

#### 各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant

〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-62-1  
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu 509-0103, Japan

#### 溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department

〒509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-82-28  
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu 509-0103, Japan

#### 研究開発センター R&D Center

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8  
8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan

#### 先端技術研究所 Advanced Technology Research Center

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1-22  
22, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan

#### 物流センター Logistics Center

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1  
1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu 509-0109, Japan

#### 東京事務所 Tokyo Office

〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-2-8 いちご内神田ビル 7F  
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8, Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan

#### 上海事務所 Shanghai Office

上海市浦東区科苑路 88 号、徳国中心 317B 室  
317B, German Center, 88 Keyuan Road, Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

### 連結子会社 Consolidated subsidiary

#### フジミコーポレーション(米国)

FUJIMI CORPORATION  
11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.  
Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

#### フジミマイクロテクノロジー(マレーシア)

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.  
Lot 13, Jalan Hi-Tech 3, Industrial Zone Phase 1  
Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia  
Phone: +60-4-403-3700 Fax: +60-4-403-3900

#### フジミヨーロッパ(ドイツ)

FUJIMI EUROPE GmbH  
Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany  
Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

#### フジミ台湾(台湾)

FUJIMI TAIWAN LIMITED  
No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township, Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)  
Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

#### フジミ韓国(韓国)

FUJIMI KOREA LIMITED  
RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, Bundang-Gu, Seongnam-Shi, Kyeonggi-Do, Korea  
Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

#### フジミ深圳(中国)

FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD.  
12A-11, Shenzhen Free Trade Center, 111 Taizi Road, Nanshan District, Shenzhen, 518067, China  
Phone: +86-755-2267-5151 Fax: +86-755-2267-5162

# 暮らしの中の FUJIMI

Fujimi's Products and  
Technology in Everyday Life

## 決済端末 Payment terminals

部品の中の水晶振動子製造過程でGCが使われています。  
GC is used for manufacturing process of crystal oscillators placed in smartphones.



## LEDライト LED lights

LEDに使われるサファイア基板を磨く過程でCOMPOLが使われています。  
COMPOL is used for manufacturing process of sapphire substrates placed in LED lights.



## デジタルTV Digital TVs

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips of digital TVs.



## 自動車 Automobiles

ボディを磨くのにGC、WAが使われています。  
GC and WA are used for polishing process of automobile bodies.



## 複合機 Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in multifunction printers.



## 飛行機 Aircraft

フラップ・スラットレールに溶射材が使われています。  
Thermal Spray materials are used for flap-slat rails.



## パソコン Personal computers

ハードディスクを磨く過程でDISKLITEが使われています。  
DISKLITE is used for manufacturing process of hard disks placed in personal computers.



## メガネ Eyeglasses

レンズを磨く過程でPOLIPLAが使われています。  
POLIPLA is used for polishing process of eyeglasses lens.



## スマートフォン Smartphones

部品の中のICチップ製造過程でFO、GLANZOX、PLANERLITE等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in terminals.

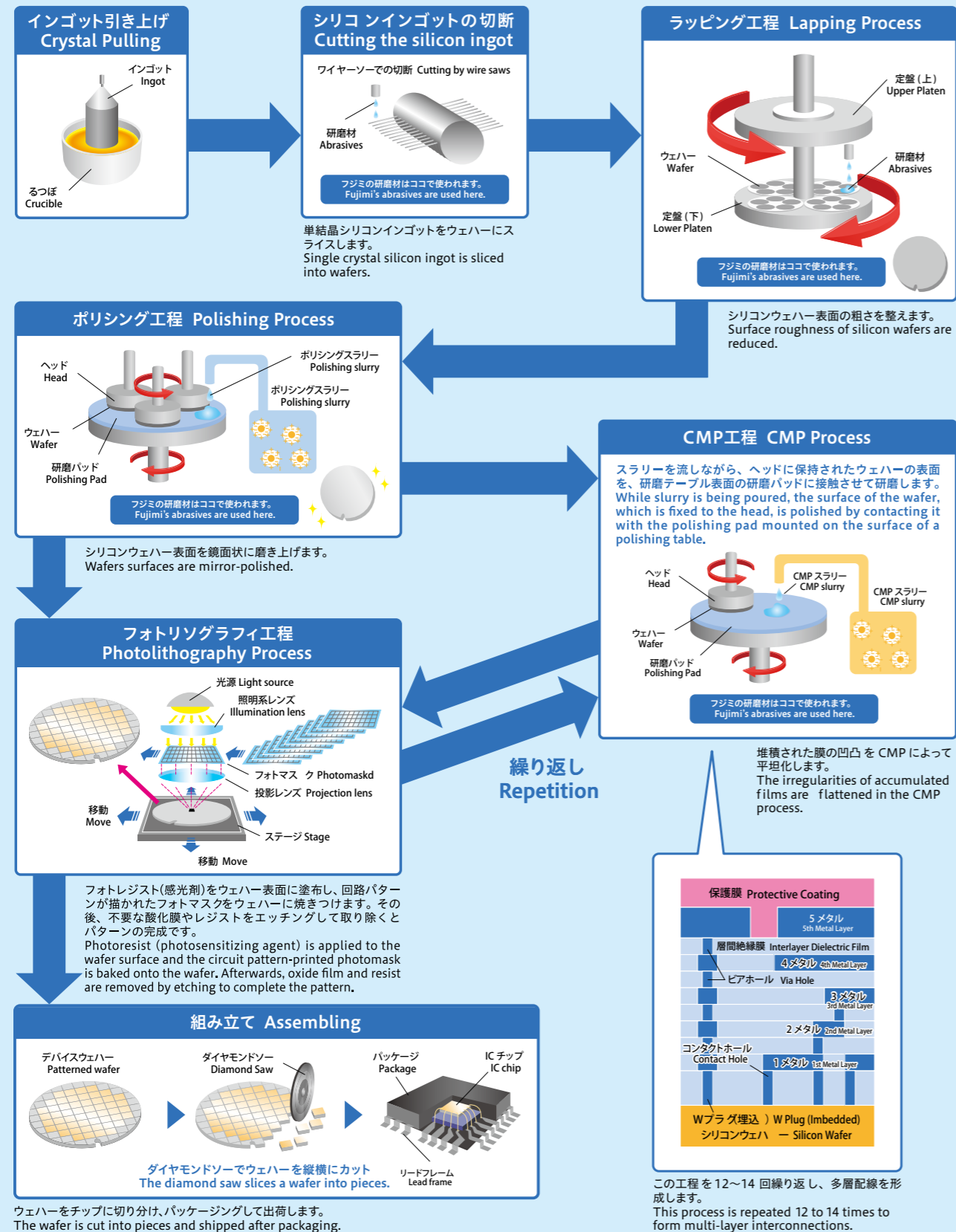


# 製造工程の中のフジミ

## Fujimi's Products in Manufacturing Process

### 半導体デバイス製造に使われるフジミの製品

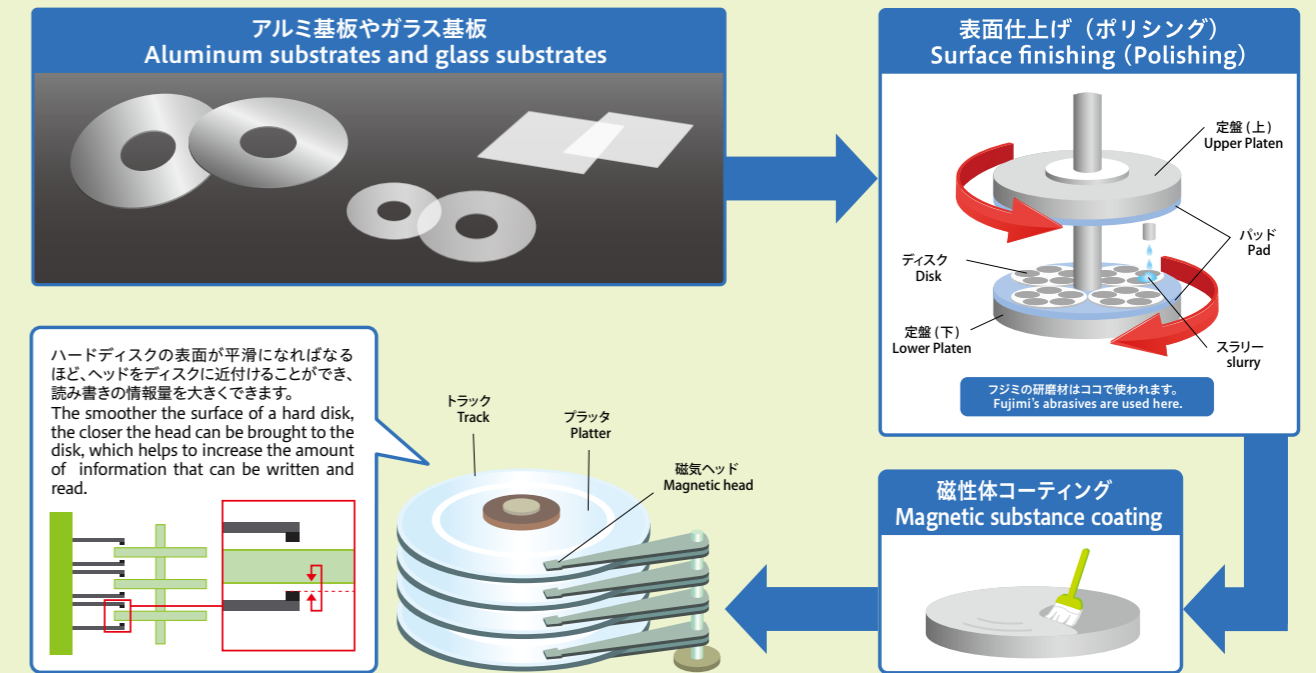
#### Fujimi's products used for semiconductor device production



※イラストはイメージです。実際の工程とは異なることもあります。  
The illustrations are only example images. The actual process may vary from the illustrations.

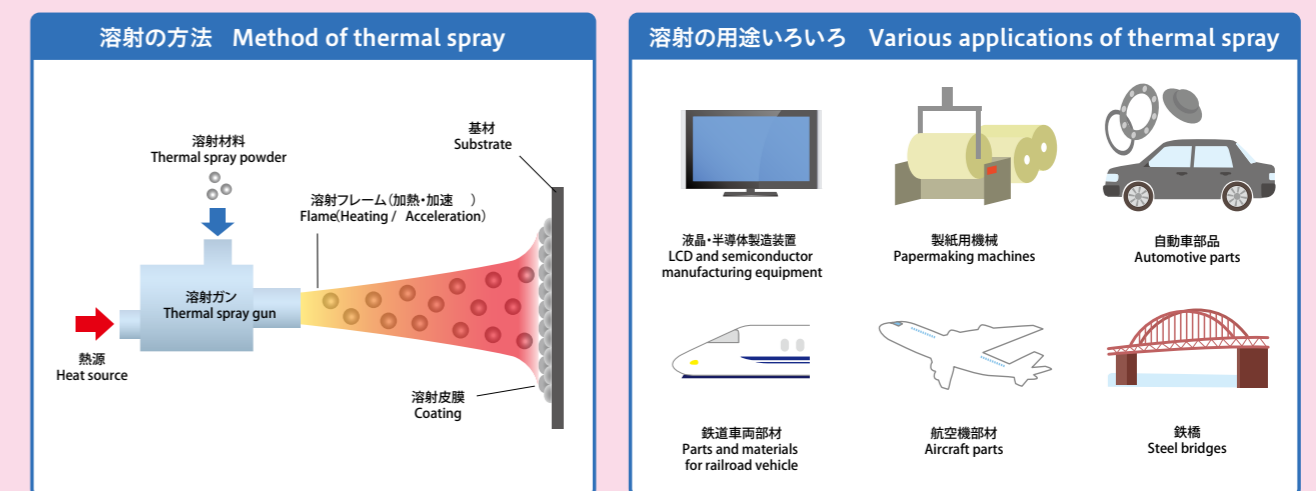
### ハードディスクの構造

#### Structure of hard disks



### 溶射とさまざまな用途

#### Thermal spray and various applications



溶射材料を溶射フレームに投入し、基材へ衝突、堆積させることで機能的皮膜を作製する。 (Thermal spray powder is supplied into the flame, then deposited on the substrate to form functional coatings.)

過酷な条件下で使用される機械部品や構造物を熱や腐食、摩耗から守り、長持ちさせる目的で使われる溶射材。その用途は、鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋など多岐にわたっています。 (Thermal spray is used to protect machine parts and structures that are used under extreme conditions against heat, corrosion, and abrasion, and to make them durable. Thermal spray is applied to a variety of fields including railroads, LCD and semiconductor manufacturing equipment, gas turbines for power generation, papermaking machines and steel bridges.)

# 経営指標

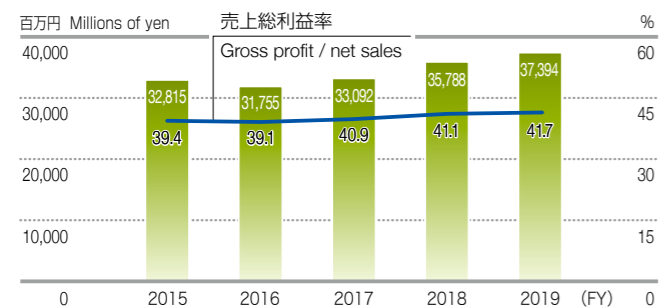
## Selected Financial Data

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 収益性 Profitability

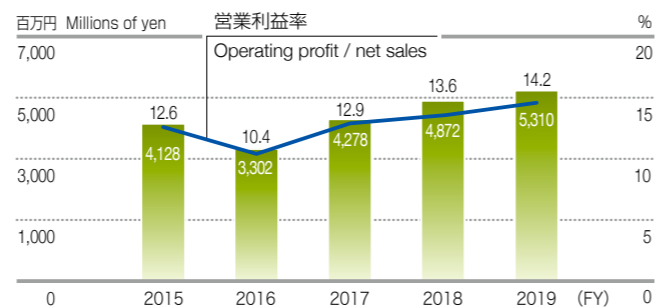
#### 売上高/売上総利益率

##### Net Sales and Gross Profit / Net Sales



#### 営業利益/営業利益率

##### Operating Profit and Operating Profit / Net Sales



#### 経常利益/経常利益率

##### Ordinary Profit and Ordinary Profit / Net Sales



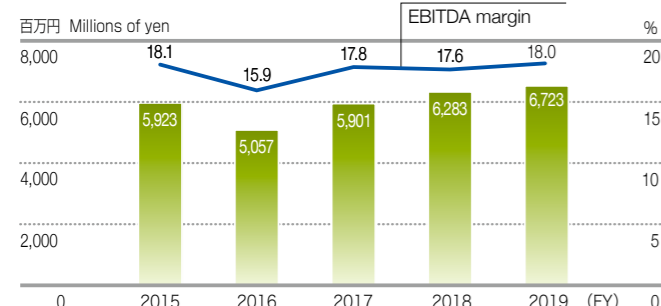
#### 親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率

##### Profit Attributable to Owners of Parent and Return on Sales



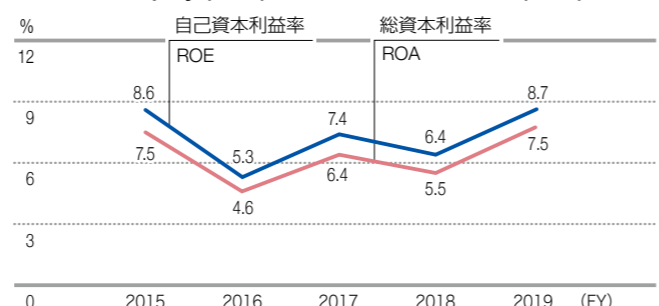
#### EBITDA/EBITDAマージン

##### EBITDA / EBITDA Margin



#### 自己資本利益率/総資本利益率

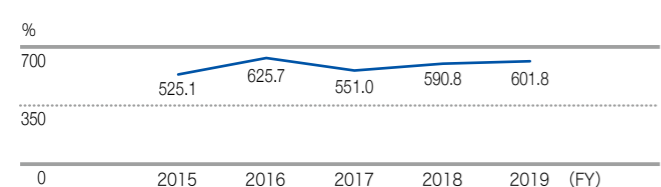
##### Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



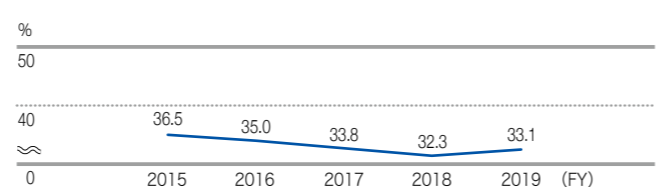
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 安定性 Stability

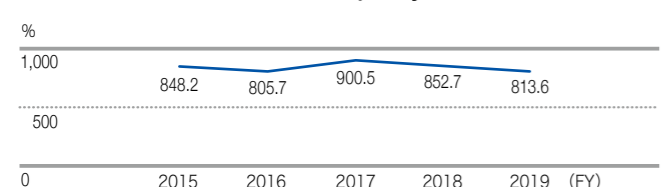
#### 流動比率 Current Ratio\*



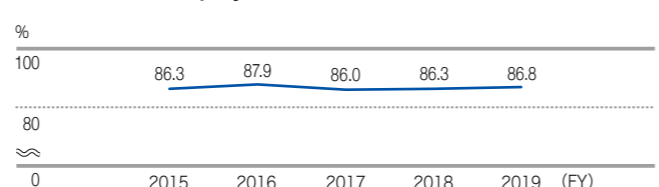
#### 固定比率 Non-current Assets Ratio\*



#### 手元流動性比率 Short-Term Liquidity



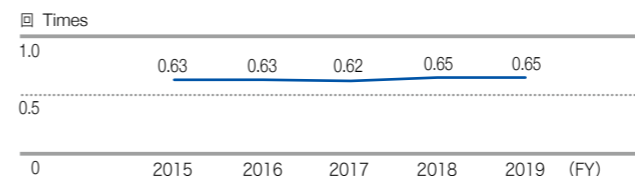
#### 自己資本比率 Equity Ratio\*



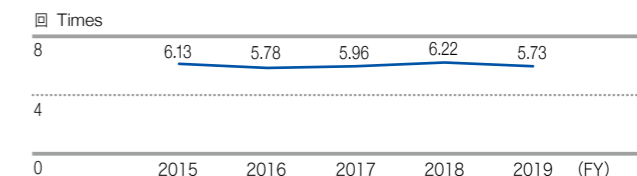
\* 「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)による会計基準の変更にもとない、当該会計基準を遡及適用した数値となっております。  
In conjunction with application of the Implementation Guidance on Tax Effect Accounting (Accounting Standards Board of Japan (ASBJ), Guidance No.28, February 16, 2018), the figures have been restated to reflect this guidance.

### 生産性/効率性 Productivity and Efficiency

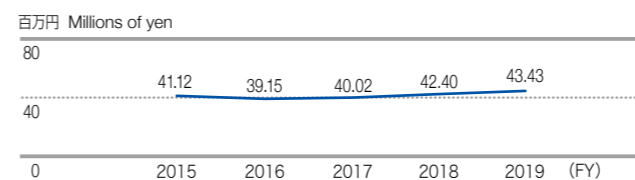
#### 総資本回転率 Total Asset Turnover



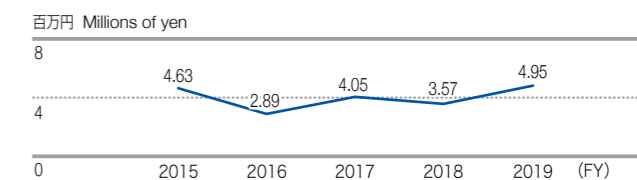
#### たな卸資産回転率 Inventory Turnover



#### 従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



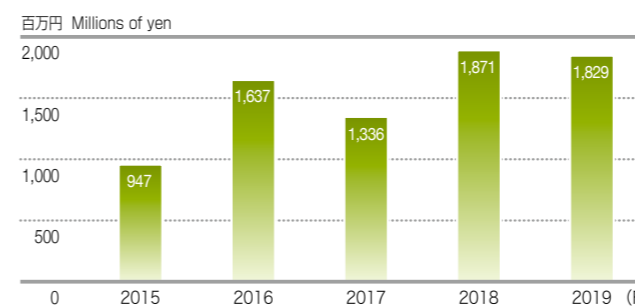
#### 従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



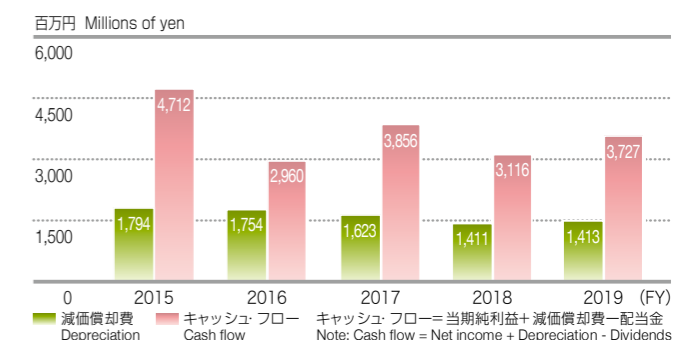
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 設備投資/研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

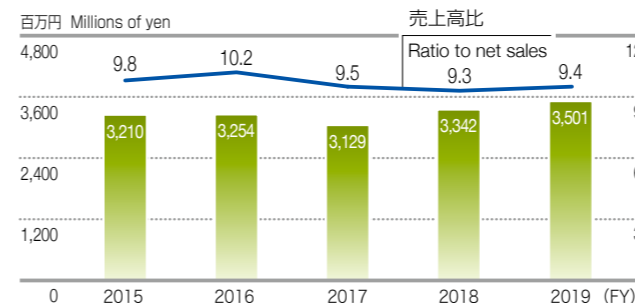
#### 設備投資 Capital Expenditures



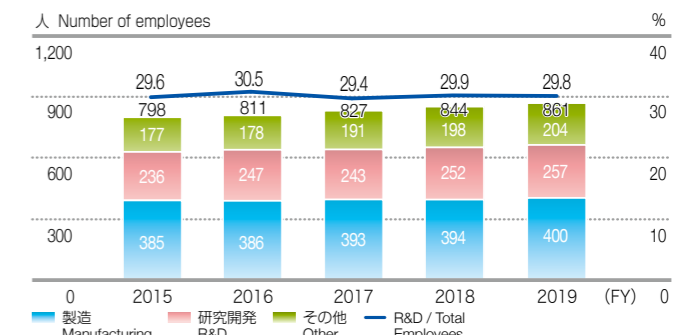
#### 減価償却費/キャッシュ・フロー Depreciation and Cash Flow



#### 研究開発費/売上高比 R&D Expense and Ratio to Net Sales



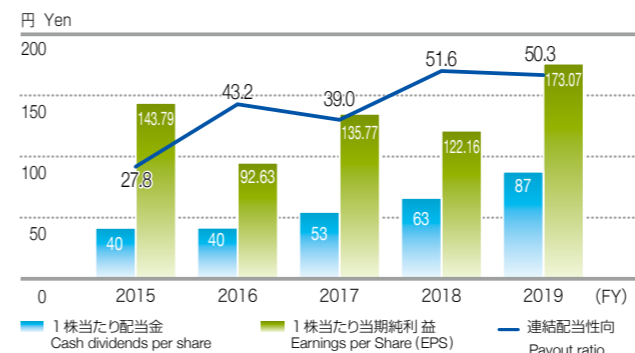
#### 研究開発要員 Number of Employees - R&D / Total -



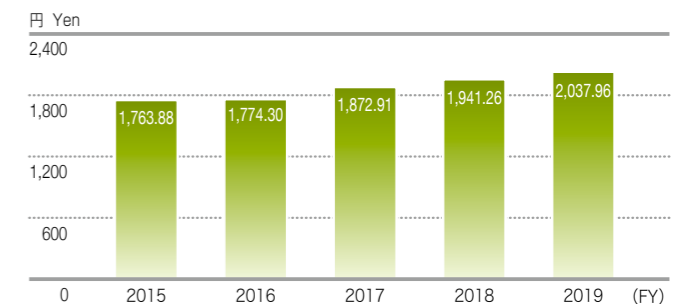
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

### 投資指標 Per Share Data and Others

#### 1株当たり配当金/1株当たり当期純利益/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Earnings per Share (EPS), Payout Ratio



#### 1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



# 連結貸借対照表

## Consolidated Balance Sheet

百万円 Millions of yen

		百万円 Millions of yen				
各年 3月 31日現在 As of March 31		2015	2016	2017	2018	2019
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	18,390	19,320	24,332	24,929	<b>21,852</b>
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	6,487	6,669	7,239	8,010	<b>8,001</b>
有価証券	Securities	4,805	1,999	500	500	<b>3,500</b>
たな卸資産	Inventories	5,606	5,383	5,721	5,793	<b>7,253</b>
その他*	Other	182	1,713	302	772	<b>634</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(28)	(11)	(17)	(23)	<b>(26)</b>
流動資産合計*	Total current assets	35,444	35,076	38,078	39,983	<b>41,216</b>
固定資産	Non-current assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物（純額）	Buildings and structures, net	7,913	7,341	7,262	7,822	<b>7,494</b>
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery, equipment and vehicles, net	1,384	1,027	1,105	1,483	<b>1,495</b>
土地	Land	3,425	3,418	3,418	3,119	<b>3,629</b>
建設仮勘定	Construction in progress	120	809	1,070	302	<b>457</b>
その他（純額）	Other, net	1,302	1,081	778	621	<b>801</b>
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	14,146	13,680	13,635	13,349	<b>13,877</b>
無形固定資産	Intangible assets	710	686	509	479	<b>400</b>
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	247	525	709	744	<b>1,455</b>
繰延税金資産*	Deferred tax assets	833	603	664	749	<b>777</b>
その他*	Other	522	112	109	141	<b>130</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(124)	(9)	(9)	(9)	<b>(9)</b>
投資その他の資産合計*	Total investments and other assets	1,478	1,232	1,475	1,626	<b>2,354</b>
固定資産合計*	Total non-current assets	16,335	15,598	15,619	15,456	<b>16,632</b>
資産合計*	Total assets	51,779	50,675	53,698	55,439	<b>57,848</b>

\*「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)による会計基準の変更にともない、当該会計基準を遡及適用した数値となっております。  
In conjunction with application of the Implementation Guidance on Tax Effect Accounting (Accounting Standards Board of Japan (ASBJ), Guidance No.28, February 16, 2018), the figures have been restated to reflect this guidance.

百万円 Millions of yen

		百万円 Millions of yen				
各年 3月 31日現在 As of March 31		2015	2016	2017	2018	2019
<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable - trade	3,319	2,703	3,226	3,269	<b>2,517</b>
未払法人税等	Income taxes payable	763	263	866	429	<b>789</b>
賞与引当金	Provision for bonuses	947	785	1,002	1,115	<b>1,073</b>
株式給付引当金	Provision for stocks payment	—	—	—	—	<b>294</b>
その他	Other	1,719	1,853	1,815	1,952	<b>2,172</b>
流動負債合計	Total current liabilities	6,750	5,605	6,911	6,767	<b>6,848</b>
固定負債	Non-current liabilities					
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	311	526	579	651	<b>701</b>
株式給付引当金	Provision for stocks payment	—	—	—	153	<b>15</b>
その他*	Other	23	19	44	18	<b>51</b>
固定負債合計*	Total non-current liabilities	334	545	623	823	<b>768</b>
負債合計*	Total liabilities	7,084	6,151	7,534	7,591	<b>7,616</b>
純資産の部	Net assets					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	4,753	4,753	4,753	4,753	<b>4,753</b>
資本剰余金	Capital surplus	5,038	5,038	5,038	5,570	<b>5,570</b>
利益剰余金	Retained earnings	38,836	40,042	41,013	42,718	<b>45,031</b>
自己株式	Treasury shares	(5,379)	(5,725)	(5,108)	(5,641)	<b>(5,641)</b>
株主資本合計	Total shareholders' equity	43,248	44,109	45,697	47,401	<b>49,714</b>
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	1,446	414	466	446	<b>517</b>
純資産合計	Total net assets	44,694	44,523	46,164	47,848	<b>50,231</b>
負債純資産合計*	Total liabilities and net assets	51,779	50,675	53,698	55,439	<b>57,848</b>

## 連結損益計算書

### Consolidated Statement of Income

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2015	2016	2017	2018	2019
売上高	Net sales	32,815	31,755	33,092	35,788	37,394
売上原価	Cost of sales	19,887	19,353	19,568	21,081	21,785
売上総利益	Gross profit	12,927	12,402	13,524	14,706	15,609
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,799	9,099	9,246	9,834	10,299
営業利益	Operating profit	4,128	3,302	4,278	4,872	5,310
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	46	28	25	59	117
その他	Other	459	68	247	76	240
営業外収益合計	Total non-operating income	506	97	273	135	357
営業外費用	Non-operating expenses	39	58	31	279	31
経常利益	Ordinary profit	4,596	3,342	4,519	4,728	5,637
特別利益	Extraordinary profit	48	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	18	568	—
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	4,645	3,342	4,500	4,160	5,637
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	1,287	733	1,282	1,240	1,384
法人税等調整額	Income taxes-deferred	(338)	262	(132)	(91)	(13)
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	3,695	2,346	3,350	3,011	4,265

## 連結包括利益計算書

### Consolidated Statement of Comprehensive Income

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2015	2016	2017	2018	2019
当期純利益	Profit	3,695	2,346	3,350	3,011	4,265
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	85	(11)	132	(52)	(61)
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	1,048	(920)	(124)	(7)	99
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	17	(100)	44	39	31
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	1,151	(1,031)	52	(19)	70
包括利益	Comprehensive income	4,846	1,314	3,402	2,991	4,336
(内訳)	Breakdown					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	4,846	1,314	3,402	2,991	4,336

## 連結キャッシュ・フロー計算書

### Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from operating activities</b>					
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	4,645	3,342	4,500	4,160	5,637
減価償却費	Depreciation	1,794	1,754	1,623	1,411	1,413
減損損失	Impairment loss	—	—	—	568	—
売上債権増減額(増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable - trade	(495)	(421)	(669)	(735)	24
仕入債務増減額(減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable - trade	442	(421)	570	2	(747)
たな卸資産増減額(増加)	Decrease (increase) in inventories	(281)	23	(398)	(67)	(1,439)
その他	Other	332	14	614	(62)	534
小計	Subtotal	6,438	4,291	6,241	5,275	5,422
利息及び配当金の受取額	Interest and dividend income received	57	38	31	56	114
法人税等の支払額	Income taxes paid	(644)	(1,519)	(779)	(1,700)	(1,183)
法人税等の還付額	Income taxes refund	641	59	291	39	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	6,491	2,869	5,785	3,671	4,397
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from investing activities</b>					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(3,719)	—	—	(4,243)	(7,825)
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	3,993	2,969	—	2,217	7,104
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	(2,800)	(2,999)	—	—	—
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	3,602	3,300	1,500	—	—
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	—	(297)	—	(130)	(813)
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(722)	(990)	(1,531)	(1,741)	(1,616)
その他	Other	(31)	(358)	(7)	15	(131)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	322	1,623	(38)	(3,882)	(3,281)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from financing activities</b>					
配当金の支払額	Cash dividends paid	(778)	(1,140)	(1,118)	(1,306)	(1,952)
自己株式の取得	Purchase of treasury shares	(901)	(345)	(644)	—	(0)
その他	Other	(7)	(1,159)	1,154	(1)	(2)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	(1,687)	(2,644)	(608)	(1,308)	(1,954)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	309	(453)	(127)	23	62
現金及び現金同等物の増加(減少)額	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	5,436	1,394	5,011	(1,496)	(777)
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	12,990	18,426	19,820	24,832	23,336
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	18,426	19,820	24,832	23,336	22,559

# 沿革 History

日付	内容	Date	Event
1950年8月	不二見研磨材工業所を創立し、人造精密研磨材の生産を開始	August 1950	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953年3月	不二見研磨材工業株式会社を設立	March 1953	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957年	東京通信工業(株)(現ソニー(株))のゲルマニウム半導体基板用研磨材ニーズに対応	1957	Supplied lapping abrasives for germanium semiconductor substrates to Tokyo Tsushin Kogyo, the predecessor of Sony Corporation.
1967年7月	シリコンウェハー用ポリシング材 [GLANZOX] を発表	July 1967	Announced the development of GLANZOX polish for silicon wafers.
1977年1月	プラスチックレンズ用研磨材 [POLIPLA] を生産開始	January 1977	Began manufacturing POLIPLA plastic lens polishing compounds.
1981年	[COMPOL] シリーズを開発	1981	Developed the "COMPOL" series.
1990年11月	ディスク用ポリシング材 [DISKLITE] シリーズを開発	November 1990	Developed the DISKLITE series, the first polishing compounds developed especially for memory disks.
1995年4月	CMP用スラリー [PLANERLITE] シリーズを開発	April 1995	Developed the PLANERLITE series of CMP slurries.
2001年1月	耐衝撃 WC サーメット溶射材 [SURPREX W2010X] を発表	January 2001	Introduced the SURPREX-W2010X, new WC cermet thermal spraying composites of enhanced impact resistance.
2002年3月	FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2002	FUJIMI AMERICA INC.* won the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2002年10月	世界初、HVOF [高速フレーム溶射] による微粉末溶射システムの確立に成功	October 2002	Successfully developed the world's first ultra-fine-grain thermal spray system employing a high velocity oxy-fuel (HVOF) process.
2003年3月	当社および FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2003	FUJIMI INCORPORATED and FUJIMI AMERICA INC.* received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2004年3月	FUJIMI CORPORATION が、インテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インプローブメント (SCQI) 賞」を受賞	March 2004	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2007年2月	東証一部、名証一部に同時上場	February 2007	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section.
2008年7月	FUJIMI CORPORATION が AMD 社の「World Class Supplier Pathfinder Award 2007」を受賞	July 2008	FUJIMI CORPORATION received the World Class Supplier Pathfinder Award 2007 from AMD.
2009年11月	研磨に適した新しい粒子「角状ナノアルミナ」の開発に成功	November 2009	Successfully developed "angular nano-aluminium" as an abrasive material.
2010年3月	世界初、500℃から成膜可能な超硬溶射材料の開発に成功	March 2010	Successfully developed the world's first tungsten carbide powders applicable to low temperature spray processes of 500℃.
2011年4月	航空・宇宙・防衛 品質マネジメントシステム (JIS Q 9100) 認証を取得 (溶射材)	April 2011	Obtained JIS Q 9100 quality management certification for aircraft, space and defense (for thermal spray materials).
2013年12月	TSMC 社の「Excellent Performance Award (優秀賞)」を受賞	December 2013	FUJIMI INCORPORATED received the Excellent Performance Award from TSMC.
2015年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2015	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2016年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2016	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2017年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インプローブメント (SCQI) 賞」を受賞	March 2017	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2018年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2018	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2019年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2019	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.

\* FUJIMI AMERICA INC. は 2003年7月に FUJIMI CORPORATION と合併し、商号を FUJIMI CORPORATION に変更しました。

\* FUJIMI AMERICA INC. merged with FUJIMI CORPORATION in 2003 July, and changed the corporate name to FUJIMI CORPORATION.

# 会社データ Corporate Data

2019年3月31日現在	As of March 31, 2019
商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	861 (単体 Non-Consolidated 588)

## 大株主一覽 Leading Shareholders

株主名 Name of Shareholder	所有株式数*1 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率*1 (%) Shareholding ratio
有限会社コマ	Koma Co.,Ltd.	3,743 13.0
株式会社フジミインコーポレーテッド	FUJIMI INCORPORATED (Treasury Stock)	3,667 12.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account)	1,618 5.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)	1,599 5.5
株式会社三菱 UFJ 銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728 2.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	717 2.4
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	639 2.2
フジミ取引先持株会	Fujimi suppliers' stock ownership program	639 2.2
一般財団法人越山科学技術振興財団	The Koshiyama Science and Technology Foundation	600 2.0
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRAD AC ISG (FE-AC)	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRAD AC ISG (FE-AC)	571 1.9

\*1 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。  
Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.

## 所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

